

Weichlöten 2011 – Forschung & Praxis für die Elektronikfertigung



Der DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V. wird zusammen mit der Fachgesellschaft Lötten im DVS am 8. Februar 2011 im Richard-Küch-Forum in Hanau die Tagung *Weichlöten 2011* durchführen. Unter der Leitung von Prof. Mathias Nowotnick, Universität Rostock, Fakultät für Informatik und Elektrotechnik, wird die Weichlöttechnik in der Elektronikfertigung von verschiedenen Seiten beleuchtet.

Ziel ist es, insbesondere den kleinen und mittleren Unternehmen neue Trends aufzuzeigen und Forschungsergebnisse zu Löttechnologien, Lotsystemen, Zusatz- und Hilfsstoffen sowie zur Prüfung und Zuverlässigkeit von Lötverbindungen anwendungsnah darzustellen.

Es werden aktuelle und zukunftsweisende Themen wie die Leistungselektronik, die Niedrigtemperaturmontage bis hin zu den Entwicklungen aus der Mikro- und Nanotechnologie behandelt. Dafür konnten bekannte Fachleute aus der Industrie und aus der angewandten Forschung als Referenten gewonnen werden, die natürlich auch gerne für Fragen und Diskussionen zur Verfügung stehen.

Sie möchten die Weichlöten 2011 unterstützen?

Auch für die *Weichlöten 2011* können wir wieder attraktive Sponsoring-Angebote unterbreiten. Wählen Sie unter Silber- und Bronzesponsor; Informationen hierzu erhalten Sie bei simone.mahlstedt@dvs-hg.de.

Termine 2010

- 6. Okt. Sitzung des Fachausschusses *7 Lötten* der Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren des DVS, Tel. +49/211/1591-0, michael.weinreich@dvs-hg.de
- 7. Okt. Sitzung der AG V6.2 *Weichlöten* im Ausschuss für Technik des DVS, Tel. +49/211/1591-0, michael.weinreich@dvs-hg.de
- 30. Nov. Sitzung der AG A2 *Fügen in Elektronik und Feinwerktechnik* im Ausschuss für Technik des DVS, Tel. +49/211/1591-0, michael.weinreich@dvs-hg.de
- 30. Nov. Gemeinsames Kolloquium von AG A2 *Fügen in Elektronik und Feinwerktechnik* und dem Fachausschuss 10 *Mikroverbindungstechnik*, Tel. +49/211/1591-0, michael.weinreich@dvs-hg.de
- 1. Dez. Sitzung des Fachausschusses 10 *Mikroverbindungstechnik* der Forschungsvereinigung *Schweißen und verwandte Verfahren des DVS*, Tel. +49/211/1591-0, michael.weinreich@dvs-hg.de
- 8. Dez. Sitzung der AG A2.4 *Bonden* im Ausschuss für Technik des DVS, Tel. +49/211/1591-0, michael.weinreich@dvs-hg.de

Termine 2011

- 8. Feb. DVS-Tagung *Weichlöten 2011 – Forschung & Praxis für die Elektronikfertigung*, Tel. +49/211/1591-0, tagungen@dvs-hg.de

7. Juni Mitgliederversammlung der *Fachgesellschaft Löten* im DVS, Tel. +49/211/1591-0, michael.weinreich@dvs-hg.de

Termine 2012

14./15. Feb. DVS/GMM-Tagung *EBL – Elektronische Baugruppen und Leiterplatten*, Tel. +49/211/1591-0, tagungen@dvs-hg.de

DVS-Merkblätter zur Mikroverbindungstechnik

DVS 2612-1 (Ausgabedatum 2004-06): Flussmittel für das Weichlöten in der Elektronik – Hinweise für den Praktiker

DVS 2612-2 (Ausgabedatum 2004-06): Flussmittel für das Weichlöten in der Elektronik – Reaktionsmechanismen, Reaktionsprodukte, Rückstände, Prüfmethoden

DVS 2613 (Ausgabedatum 2004-06): Temperaturprofiloptimierung beim Reflowlöten

DVS 2616 (Ausgabedatum 2010-08): Flussmittelrückstände und ionische Verunreinigungen auf elektronischen Baugruppen

DVS 2801-1 (Ausgabedatum 1996-04): Widerstandsschweißen in Elektronik und Feinwerktechnik – Übersicht und Grundlagen

DVS 2810 (Ausgabedatum 1992-09): Drahtbonden

DVS 2811 (Ausgabedatum 1996-08): Prüfverfahren für Drahtbondverbindungen

DVS 2812 (Ausgabedatum 2002-11): Prüfen von widerstandsgeschweißten Verbindungen in der Elektronik und Feinwerktechnik – Zerstörende und zerstörungsfreie Prüfungen

DVS 2813 (Ausgabedatum 2009-02): Widerstandsschweißen von elektrischen Kontakten

Bezug: DVS Media GmbH, Aachener Straße 172, D-40223 Düsseldorf, Tel. +49/211/1591-0, Fax -250, media@dvs-hg.de, <http://www.dvs-media.info>

Einpresstechnik

Entwicklung, Anwendung, Qualifizierung

Von Tilman Heinisch. Erste Auflage 2009. 224 Seiten.

ISBN 978-3-87480-252-9. Preis € 58,- inkl. 7 % MwSt., zuzüglich Porto

Die Einpresstechnik hat in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Nachdem sich diese Anschluss-technologie seit den 1970er-Jahren in der Telekommunikationsindustrie bewährt hat, entdecken seit einiger Zeit auch die Entwickler für automotiv und industrielle Anwendungen die Vorzüge der Einpresstechnik: hohe Zuverlässigkeit, einfache Verarbeitung und reduzierte Bestückungskosten sind nur drei der Punkte, die Entwickler und Anwender von elektronischen Baugruppen zu schätzen wissen.

Die neuen Anwendungen bringen gleichzeitig neue Anforderungen mit sich. Höhere Einsatztemperaturen, stärkere mechanische Belastungen und größere elektrische Leistungen erfordern neue Strategien bei der Entwicklung, der Fertigung und der Qualifizierung von Einpresskontakten.

Das neue Fachbuch *Einpresstechnik* trägt diesen aktuellen Anforderungen Rechnung und präsentiert das Fachwissen zahlreicher Autoren aus den unterschiedlichsten Industriebereichen.

Eugen G. Leuze Verlag KG

Karlstraße 4 · D-88348 Bad Saulgau · Tel. 07581/4801-0 · Fax 07581/4801-10
buchbestellung@leuze-verlag.de · www.leuze-verlag.de